

高出力半導体素子における高放熱構造を 実現するウェハ常温接合技術

日暮 栄治*, 須賀 唯知*

Room-Temperature Wafer Bonding for High-Heat Dissipation Structure in High-Power Semiconductor Devices

Eiji HIGURASHI* and Tadatomo SUGA*

* 東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻 (〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1)

*Department of Precision Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo (7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656)